

8414

제품 정보



40µm 반투명 Z축 전도성 HAF 테이프

제품 설명

tesa® HAF 8414는 도전성 입자가 함유된 반투명 열활성 점착 테이프입니다.

특성:

- 한번의 작업으로 안정적인 칩 접착력과 전기적 연결성을 유지함
- 일반적인 삽입 공정에서의 우수한 작업성
- PVC, ABS, PET, 폴리카보네이트 카드(DI)에 적합
- 실버 잉크 피착제에 적합 (RFID)

입자 지름 중간값: 40µm

특성

- Chip module bonding and electrical connectivity in one step
- Good workability on all common implanting lines
- Suitable for PVC, ABS and PC cards (Dual Interface (D.I.) and contactless cards)
- Suitable for silver ink substrates and wire antenna
- Mean particle diameter: 40 µm

Applications

tesa® HAF 8414는 안정적인 전기 연결과 강력한 접착력이 필요한 경우를 위해 설계된 제품입니다. 듀얼 인터페이스(DI) 카드에 칩 모듈을 삽입하거나 RFID 태그에 스트랩을 부착하는 것이 주요 용도입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|----------|------|
| • 기재 소재 | 없음 | • 이형지 종류 | 글라신지 |
| • 점착제 종류 | 혼성중합체 | • 컬러 | 반투명 |

추가정보

Processing:

Please note that optimal parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies, antenna material or chip-modules as well as individual customer requirements. The bonding time depends on the heat transition of the used substrates. Additionally we recommend a cooling step directly after the bonding step. Thereby pressure should be applied until film temperature decreases below softening temperature (approx. 110 °C).



8414

제품 정보

추가정보

The following data are recommendations for the initial set-up of machine parameters.

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. An accurate pre-lamination is in particular important for tesa HAF® 8414 in order to ensure a good adhesion and a good conductivity inside of the final product.

Machine setting:

- Temperature 130 - 150 °C
- Pressure 3 - 4 bar
- Time 2.5 m/min.

2. Conductive Bonding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die-cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. Depending on the type of the implanting line, single step or multiple step process can be used. Today, most implanting machines have multiple heat press steps.

Single step process - Machine setting:

- Temperature¹ 160 – 220 °C
- Pressure 65 - 130 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 130N/module
- Time 2 x 0,7 s. / 3 x 0.5 s.

¹Temperature recommendations refer to what can be measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

- PVC 180 – 190 ° C
- ABS 180 – 190 ° C
- PET 190 – 200 ° C
- PC 200 – 220 ° C

To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry. Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.



8414

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08414>